

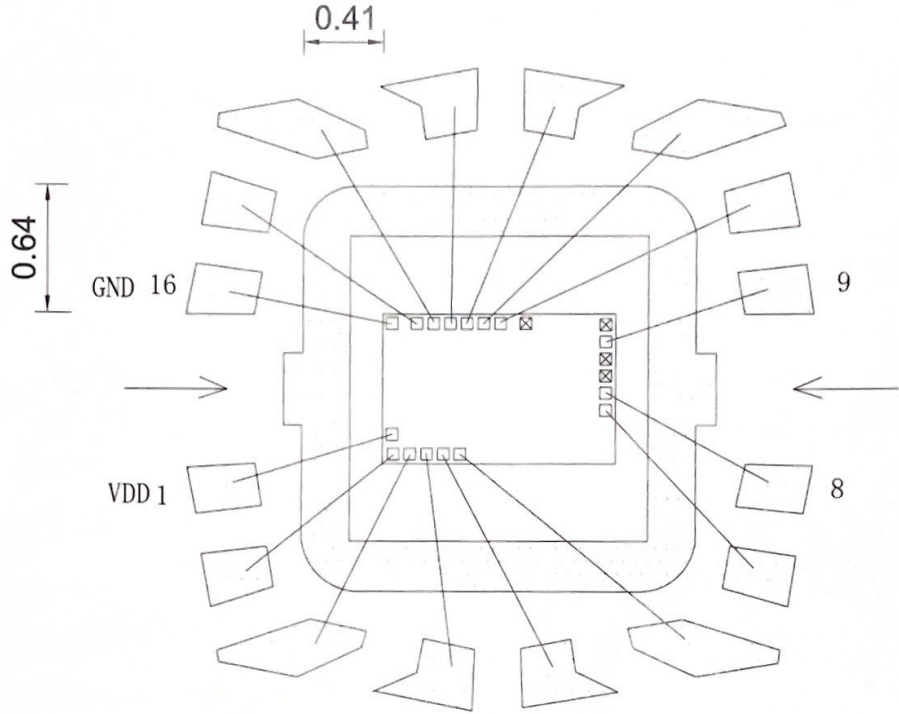


江苏芯丰集成电路封装压焊图		图号:314BD012	版本	A.0
贴片方向 (芯片与片环方向示意图)	框架传输进料方向 第一个孔为椭圆孔			
				
备注及特殊要求 (Remark&Special Instruction)				
框架到芯片最高点的线弧高度<550um 居中装片				



请仔细核对焊线位置, 以及材料选择。如无误
请签字回传, 谢谢!

客户回签: 模循阅 2024.4.19

顶针		点胶方式		如选择UV膜 请确认 产品是否可以照 射紫外线, 如不能请讲明	<input type="checkbox"/> UV膜 <input checked="" type="checkbox"/> 蓝膜	风险监控: 低风险		
单顶针	多顶针	点胶	画胶					
	/	•	/					
产品型号 (Product Type)	HS26P10		线材直径 (Wire Diameter)	银合金线0.8mil	芯片减薄厚度 Chip thinning thickness	300±10um		
芯片名称 (Die Name)	HS5085		压焊点尺寸 (Pad Opening)	60X60um	装片胶 Epoxy	首选	9246LB5 (导电胶)	
芯片尺寸 (Die Size)	1.195X0.755mm		最小压焊间距 (Min Pitch)	86um	(二选一)	备选	/	
封装形式 (Package Type)	SOP16L (9.9×3.9×1.4 e=1.27)		先焊线 (Wire Bond Start)	PIN16	塑封料 Molding Compound	首选	EMC-GR710F GN	
引线框 (Lead Frame)	SOP16L (12R) (80×80) -H		焊线总数 (Quantity of Wire)	16	(二选一)	备选	EMG-600-2-SP1	
L/F电镀方式 (L/F Plating Type)	雾锡		最长线长/总线长 (Length of Wire)	1.49/17.649mm	CUP/BOAC	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		
晶圆尺寸/切割方式 (Wafer Size/Cutting Mode)	8寸/刀片开槽+刀片切割		顶层铝厚度 (Top aluminum thickness)	1.5um	RF 芯片	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO		
吸嘴 (suction nozzle)	RT-020-020-FT		切割道 (Cutting Way)	60um	LOW-K芯片	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO		
拟制 Prepared by	顾馨 2024.04.18		审核 Checked by		批准 Approved by			